

【原因、判断要点、发生工序】字符印刷后附着某种物质所引起的（字符印刷后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Some object is attached to the surface after the symbol mark is printed (After symbol mark printing process)



【コメント】
顕微鏡倍率×20

【注釋】
显微镜倍率 ×20

【Comments】
Magnification: ×20

3-2-1-5 シンボルマーク印刷部銅見え／在字符部位露銅／ Exposed copper in peeled symbol mark print

【特徴】シンボルマークベタ印刷部がSR毎剥離して銅導体が見え、更にはんだが付着している状態の欠陥

【特征】字符下面的SR剥落，露出铜导线，并且附着焊料的缺陷。

【Characteristics】A symbol mark printed of a wide area is peeled off together with solder resist to cause an exposed copper conductor, to which solder is attached.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR印刷時に付着した片状異物が、HAL工程の熱により剥離して出来たもの（SR印刷～HAL工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR印刷时附着片状杂物，在HAL工序热的作用下剥落所引起的（SR印刷～HAL工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】thin foreign object is attached during solder resist printing and peeled off by heating at HAL process, causing the defect. (Solder resist printing - HAL process)



【コメント】
SRもその上に印刷されたベタシンボルマークも剥離して導体が露出するとともに、HALめっきの付着もみられる。
顕微鏡倍率×

【注釋】
SR上的字符剥落，露出导线的同时在HAL工序附着焊料。
显微镜倍率 ×

【Comments】
Both solder resist and solid symbol mark printed on the solder resist are peeled and the conductor is exposed. Solder is attached there at HAL process.
Magnification: ×

3-2-2 その他（シンボルマーク欠陥）／其它（字符的缺陷）／ Others(symbol mark defects)

3-2-2-1 シンボルマークインク垂込／字符油墨的垂入／ Symbol mark ink filled hole

【特徴】シンボルマークインクが部品穴内に入り込んでいる状態の欠陥

【特征】字符油墨垂入元件孔的缺陷。